

トランスクリプト

司会：冒頭のあいさつ

それでは、お時間となりましたので、東京エレクトロン株式会社 2024年3月期 第3四半期の決算説明会を開催いたします。本日はお忙しい中、ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。わたくし、司会進行を務めます、IR室の八田です。よろしくお願いいたします。

それでは、本日の出席者の紹介をいたします。代表取締役社長・CEO 河合 利樹でございます。

河合：河合でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

続きまして、常務執行役員ファイナンス担当 川本 弘でございます。

川本：川本でございます。本日はよろしくお願いいたします。

プレゼンテーションに先立ち、私から、本日の会の流れについてご説明させていただきます。これより、川本、河合のプレゼンテーションをお聞きいただきます。その後 18:30 まで、質疑応答のお時間を設け、皆さまからのご質問をお受けしたいと思っております。本説明会は、Webex を 2 回線使い、日英の同時通訳でおこなっております。先日、メールでご案内させていただいたとおり、音声のみお聞きになりたい方は、電話でもご参加いただけますが、ご質問されたい方は、PC もしくはモバイル端末のアプリをお使いください。また、本説明会は機関投資家さま・アナリストさま向けの説明会となっております。大変申し訳ございませんが、回答は、従来どおり機関投資家・アナリストの方々のご質問に限らせていただきます。本説明会につきましては、後日、日英の音声配信を HP 上に掲載いたしますので、こちらも併せてご利用ください。

それでは、はじめに、川本より、「連結決算の概要」についてご説明申し上げます。よろしくお願いいたします。

本決算 連結決算の概要

川本 弘（常務執行役員 ファイナンスユニット GM）

改めまして、川本でございます。私の方から東京エレクトロン株式会社 2024年3月期第3四半期連結決算についてご説明申し上げます。

損益状況（四半期）：スライド 4

まずはじめに、四半期ごとの損益状況についてご説明いたします。青枠の部分を中心にご覧ください。第3四半期の売上高は、主に中国向けの売上の増加に伴い、前四半期比 8.4%増加の 4,636 億円となりました。売上総利益は前四半期比 17.1%増加の 2,221 億円。売上総利益率は、付加価値の高い製品構成比が増加したことにより、過去最高の 3.6 ポイント増加の 47.9%となりました。営業利益でございますが、37.8%増加の、1,324 億円となりました。営業利益率に関しましては、売上総利益率の増加と、販管費比率の低下により、6.1 ポイント増加の 28.6%となっております。また、親会社株主に帰属する当

トランスクリプト

期純利益は、前四半期比 38.7%増加の 1,015 億円となりました。なお、一番右の前年同期比につきましては、売上高は前期比マイナス 0.9%となったものの、前述のとおり、ミックスの改善により、売上総利益、営業利益ともに増加しております。研究開発費につきましては、成長に向けた研究開発投資を継続しております。497 億円となりました。設備投資額は九州の開発棟の建設などにより、318 億円。減価償却費は 138 億円となりました。

損益状況（四半期）：スライド 5

こちらは、先ほどご説明させていただいた業績を時系列でグラフで示したものになります。ご確認ください。できればと思います。

地域別売上高構成比（FY2024 Q1～Q3）：スライド 6

こちらは、「地域別売上高」になります。今期から単一セグメント開示となっておりますので、全社合算の地域別売上高構成比のグラフでございます。ご覧のとおり 3 四半期の売上高構成比については、第 2 四半期に引き続き、中国における成熟世代向け設備投資が活発におこなわれ、中国比率は、46.9%と高水準となりました。

SPE 新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）：スライド 7

こちらは、「SPE 新規装置のアプリケーション別売上構成比」となります。第 3 四半期につきましては、下からノンメモリ 65%、不揮発性メモリ 4%、DRAM31%となりました。DRAM とノンメモリにおいては、第 2 四半期同様に、中国顧客の投資が活発におこなわれた結果、前四半期から売上高が上昇いたしました。

フィールドソリューション売上高（四半期）：スライド 8

こちらは、「フィールドソリューション売上高」になります。第 3 四半期は、改造売上は低調だったものの、パーツ売上が回復し、第 2 四半期と変わらず、1,044 億円となりました。

貸借対照表（四半期）：スライド 9

続きまして、バランスシート、「貸借対照表」をご説明いたします。資産合計は、2 兆 2,174 億円となりました。現金同等物は、3,524 億円。売上債権及び契約資産は、3,350 億円。棚卸資産は、今後の市場回復に備えた調達により、前四半期比 294 億円増加の 7,780 億円となりました。投資その他の資産は保有する株式の時価上昇などにより、前四半期から 235 億円増加し、3,321 億円となりました。続きまして、右側の負債・純資産でございますが、負債は、216 億円減少の 6,397 億円。純資産は、1 兆 5,776 億円となりました。純利益 1,015 億円の計上と、それに対し、株主様への配当を行った結果、前四半期比 473 億円増加の 1 兆 5,776 億円となりました。なお、自己資本比率は 70.5%となりました。

キャッシュ・フロー（四半期）：スライド 10

続きまして、「キャッシュ・フロー」になります。この四半期における営業キャッシュ・フロー獲得は、950 億円ございました。投資キャッシュ・フローの支出は、344 億円。財務キャッシュ・フローでは

トランスクリプト

693億円を支出いたしました。こちらは主に配当のお支払いによるものであります。これらの結果、フリーキャッシュフローは、606億円となりました。

決算の結果についてのご報告は以上でございます。ありがとうございました。

司会：次のプレゼンテーションの紹介

それでは、続きまして、CEO 河合より、「事業環境および業績予想」について、ご説明申し上げます。よろしく願いいたします。

事業環境および業績予想

河合 利樹（代表取締役社長・CEO）

河合でございます。事業環境および業績予想についてご説明いたします。

事業環境（2024年2月時点でのWFE市場の見方）：スライド12

まず、「事業環境」について、ご説明します。昨年 CY2023 の WFE 市場につきましては、前回決算発表時には、85 から 90B ドル程度と見ておりましたが、最終的には、95B ドル程度で着地したと試算しております。中国顧客の投資前倒しにより、上方修正しました。本年 CY2024 の WFE 市場は、過去最高であった 2022 年と同等の、100B ドル程度になると予測しています。中国顧客の投資は継続し、また、年後半から、最先端 DRAM 向け投資が回復すると見込んでおります。CY2025 には、先行する DRAM に加えて、NAND、および先端ロジック/ファウンドリの設備投資も本格回復すると予測しております。その牽引役としましては、年率 31% で拡大する AI サーバーが挙げられます。最先端の CPU、DRAM、NAND のほか、生成 AI 向け GPU、メモリを積層しパッケージングする HBM などの事業機会があります。加えて、サーバーだけでなく、PC やスマートフォンなどのデバイスにも AI が搭載されることや、コロナ期に購入した製品の買い替え需要、そして企業の IT 投資も半導体需要を押し上げる要因になると見えています。これらを背景に、2025 年の WFE は、二桁成長になると期待しています。

FY2024 Q3 事業進捗：スライド13

次に、「FY2024 第3四半期の事業進捗」についてご説明します。業績については、先ほど川本から説明しましたとおり、売上・利益、ともに順調に進捗しました。戦略製品のペネトレーション、将来成長につながる開発評価も、中期経営計画どおり、着実に進捗しております。一例として、DRAM 向け HARC エッチング装置や、先端ロジック向けシリコンエッチング装置、裏面ベベル洗浄装置など、着々と POR 獲得活動が進展しています。以前ご紹介した、極低温クライオエッチングの量産に向けた評価も順調です。HBM 向けウェーハボンディング/デボンディング装置は、量産受注が急拡大し、半年前の想定より 2 倍以上の引き合いをいただいております。また、昨年 12 月のセミコンジャパンで、新製品・新技術、そして新たな環境目標をリリースしました。一つ目は、レーザー剥離技術です。レーザーリフトオフと

トランスクリプト

呼ぶその技術は、半導体の更なる高性能化の為3次元実装をおこなう際にウェハーを薄くする工程に代わりに、永久接合された2枚のシリコンウェーハに対し、上部のシリコンウェーハと、集積回路を有する層を、レーザーで剥離する新たな技術です。従来のプロセスフローを簡素化し、純水使用量を従来比で90%以上削減できるなど、環境負荷を大幅に低減できる革新的な技術でございます。ふたつめは、Ulucus-Gです。当社独自の技術を活用し、EUVや高密度3次元実装等を適用した最先端デバイスに求められるウェハーの平坦化を実現します。これにより、半導体の技術革新を推進し、WFE市場の成長を後押ししてまいります。そして、ネットゼロの達成目標年を10年前倒し、2040年としました。この実現に向け、新たな製品環境目標として、ウェハー1枚当たりのCO2換算排出量を「2021年度比35%削減」と再設定しました。地球の環境保全に努め、ネットゼロを積極的にリードしていく所存です。

FY2024 業績予想：スライド 15

次に、「FY2024の業績予想」について説明いたします。今回、Q3の実績および足元の状況を勘案し、売上予想を1,000億円上方修正いたします。通期売上高は、1兆8,300億円、売上総利益は、8,170億円、営業利益は、4,450億円、親会社株主に帰属する当期純利益は、3,400億円を予定しています。下期売上高は1兆円を超えるレベルに回復する見込みでございます。

FY2024 SPE 新規装置売上予想：スライド 16

こちらは、第4四半期のSPE部門新規装置の売上予想です。ご覧のとおり、第一四半期を底に、SPE新規装置の売上は回復しております。

FY2024 研究開発費・設備投資計画：スライド 17

次に、「研究開発費と設備投資の計画」です。こちらは変更ございません。FY2024は、いずれも過去最高となる見通しで、研究開発費は、2,050億円、設備投資、減価償却費はそれぞれ、1,240億円、570億円を見込んでおります。

半導体市場はCY2030には\$1兆に：スライド 18

さて、デジタル化と地球環境保全に向けた脱炭素化の両立に向け、半導体の用途と重要性はますます高まっており、このようなことから、ご覧のとおり、2030年に半導体デバイス市場は1兆ドルに到達すると予想されています。

未来に向けた成長投資（FY2025～FY2029）：スライド 19

そのような中、当社の成長ポテンシャルを最大化するため、今後5年間で、研究開発費1.5兆円、設備投資7,000億円を計画します。また当社は、企業の成長は人、社員は価値創出の源泉と位置付けており、毎年2,000人、5年間で1万人の新規採用を計画しております。

FY2024 配当予想：スライド 20

次に、「配当予想」についてです。中間配当は、148円でしたが、期末につきましては、業績予想の上方修正に基づき、219円を予定しております。

トランスクリプト

総還元額：スライド 21

こちらは最後のスライド、「総還元額の推移」になります。今期の総還元額は、先ほどご説明した 1 株当たりの配当額と、自己株式取得を合わせ、2,902 億円 と、過去最高の総還元額になる見込みです。

私からのご報告は以上となります。ご清聴ありがとうございました。